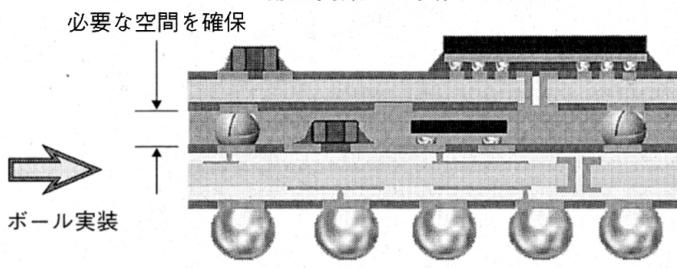


2012年(平成24年)4月6日(金曜日)

部品内蔵3D実装への応用



銅核ボールを用いた部品内蔵の基板例

長谷川永悦社長は「半導体の微細化を大きな課題として取り組んでいた。ソルダーボールは、ボル径が100番目から最小20番目

同社は、独自のシラスピーラスガラスを利用した膜乳化法で、公差高真球度のソルダーボールを製造して、昨年には富士崎工場(千住技術研)で量産体制も整えた。

長谷川永悦社長は「パンプ形成のソルダーボールは、ボル径が100番目から最小20番目

千住金属工業は、はんだ材料の技術を応用したソルダーボールのビジネスを強化しており、その一環として3次元実装向けに銅ボールにはんだメッキを施した「銅核ボール」を開発、市場への普及に乗り出している。

ソルダーボール(マイク)ケージの部品接続に用いられる、スマートフォンやタブレットPCに代表されるモバイル機器用として、これまでの技術を開発した。

スマートフォンに代表されるモバイル機器用として、落下衝撃性に優れたソルダーボールM61や、はんだ量が不足するパッドやスルーホール部に接合補強するチップソルダーも製品化している」と話す。

ソルダーボールは、ソルダーボールの技術を生かして開発した。部品内蔵3次元実装における半導体や部品を内蔵する、精度の高い空間確保を可能にする。

銅核ボールを基板間に挟み込むことによって、表面層のはんだが基板間の電気接続を可能にし、はんだ付け温度では溶融しない核の銅ボールが、精度の高い一定の空間を確保してくれます。銅核ボールは80番目から各種をそろえている、なんだメックは、用途に応じ

千住金属工業

3次元実装向け「銅核ボール」開発



長谷川 社長



発行所 電波新聞社

東京本社
東京都品川区東五反田1-11
-15 〒141-8715
⑨03(3445)6111(大代表)大阪本社
大阪市中央区北浜3-2-25
(京阪淀屋橋ビル6階) 〒541
-0041
⑨06(6203)3361(大代表)西部本社
福岡市博多区博多駅前1-13
-23(福岡ビル) 〒812-0011
⑨092(431)7411(大代表)
©電波新聞社 2006